भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
अभियांत्रिकी कार्यालय
राजा भोज विमानपत्तन, भोपाल

अंतरकार्यालयीन टिप्पणी

संदर्भ:– भा.वि.प्रा./भोपाल/स.म.प्र.(अभि.वि.)–I/2020–21 दिनांक: 25.02.2021

विषय:- ई-निविदा(Envelop-II) खोलने बाबत।

कार्य का नाम: Misc. Electrical Works. SH: SITC of new cooling tower i/c dismantling of old cooling towers and relocation of water softening plant at Raja Bhoj Airport, Bhopal.
(Tender ID- 2021_AAI_69154)

निविदा खोलने की तारीख(कवर-II) : ~~26/02/2021~~ 01.03.2021 AT 1200 HRS

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य की वित्तीय निविदा (कवर-II) दिनांक ~~26.02.2021~~ 01.03.2021 को 1200 बजे अधोहस्ताक्षरी की कार्यालय में खोली जायेगी।

निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्य निम्नानुसार है :

क्र.	नाम एवं पदनाम	निविदा कवर खोलने हेतु
1.	श्री ददन सिंह , स.म.प्र.(अभि.वि.)	कवर – II खोलने हेतु
2.	श्री पवन सिंह चौहान, वरि.प्रबंधक (वित्त)	कवर – II खोलने हेतु

अत: आपसे अनुरोध है कि स्वयं अथवा आपके द्वारा अधिकृत अधिकारी को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजने का कष्ट करें ताकि निविदा सही समय पर खोली जा सके।

सहायक महाप्रबंधक (अभि.वि.)-I
25/2/2021

प्रति,

1. सहायक महाप्रबंधक (अभि.वि.)-II
   भाविप्रा, राजा भोज विमानपत्तन,
   भोपाल
2. वरि.प्रबंधक (वित्त)
   भाविप्रा, राजा भोज विमानपत्तन,
   भोपाल

25/2/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar Zutshi
Date: 2021.03.01 11:53:20 IST
Location: eProcurement System for Central PSUs